

内蒙古欧晶科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-03

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员名称	线上参与公司 2025 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 9 月 8 日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	总经理：安旭涛 董事、副总经理兼财务总监：马雷 副总经理、董事会秘书：刘敏 独立董事：吴振宇
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复，主要内容如下： 1、六部委“反内卷”座谈会后，行业限产挺价对公司经营有何影响？ 近期，工信部等六部委召开的光伏产业座谈会，会议要求光伏产业各方要深刻认识规范竞争秩序对光伏产业高质量发展的重要意义，共同推动产业健康可持续发展，综合治理低价无序竞争、推动落后产能退出。行业限产保价有助于优化光伏行业资源配置，提升整体竞争力，有助于逐步优化光伏行业供需结构及竞争格局，助力行业高质量健康发展，近期硅料、硅片报价已有所上涨，体现了政策引导的积极效果。公司作为光伏领域提供配套辅材的一员，后续如光伏产业步入渐进式复苏周期，公司营业收入与盈利将有望同步行业情

况。

2、2025 年上半年公司在拓展市场有哪些具体举措？取得哪些进展？

2025 年上半年，公司在市场拓展上聚焦核心业务深化与新区开拓，太阳能级石英坩埚领域，一方面与 TCL 中环、阿特斯、英发、Qcells 等大中型硅片生产商保持稳定合作，另一方面推进与晶澳科技、晶科能源、天合光能、高景太阳能等头部企业的产品验证，为后续批量供货铺垫；半导体石英坩埚领域，加强生产与销售并已与北京、山东、内蒙古、四川等区域客户达成合作及供货，持续推动半导体石英坩埚产品在头部客户的验证和推广。市场覆盖成果显著，国内产品销售覆盖 14 个省、自治区及直辖市，新增客户 16 家；国际市场上，产品销售辐射至美国、印度和印度尼西亚等国家。

3、半导体行业上半年呈现复苏态势，请问这对公司半导体石英坩埚业务的订单量和市场需求是否有产生实际拉动？

2025 年上半年，全球及中国半导体市场规模显著增长，特别是在物联网、人工智能等新兴技术的快速发展下，国内对半导体产品的需求持续上扬。此外，随着半导体硅片国产化率的提升，半导体石英坩埚市场发展迅速，公司半导体石英坩埚产品逐步实现进口替代，已与北京、山东、内蒙古、四川等区域的客户达成合作并供货，形成销售收入。半导体行业的复苏态势对公司半导体石英坩埚业务产生了积极影响，为公司带来了良好的发展机遇。

4、结合当前行业形势和公司经营状况，管理层对公司下半年的业绩表现有怎样的预期？

目前光伏行业面临供需失衡和价格竞争加剧的双重挑战，近期工信部等六部委召开光伏产业“反内卷”座谈会，随着行业产能出清和去库存的影响，未来光伏行业竞争环境有望逐步优化，行业集中度提升，有助于行业高质量健康发展。公司管理层将继续加强财务管理，控制财务风险，同时

	紧跟行业发展趋势，持续加强研发技术创新，实施有效的降本增效措施，提升产品性价比，保持公司产品在市场上的竞争优势。此外，公司将加大光伏和半导体行业下游客户的拓展力度，积极挖掘产业链上下游细分行业机会，改善公司经营状况，提升整体竞争力和公司业绩。虽然短期内业绩承压，但长期来看，光伏行业和半导体行业均有望保持增长态势，公司将继续加大技术研发、品质管理，夯实公司在相关领域的竞争力，实现业绩的稳步改善。 5、公司在光伏和半导体两个领域均有布局，在资源分配上是否会有所侧重？ 公司在光伏和半导体两个领域均有布局。在光伏领域，公司作为光伏硅片生产核心辅材供应商，面对行业供需错配与同质化竞争加剧的压力，公司持续加强研发技术创新，实施有效的降本增效措施，提升产品性价比，保持公司产品在市场上的竞争优势。同时，公司也在加大半导体石英坩埚领域的投入，以提升半导体坩埚在产品结构中的占比，分散行业风险。公司依托多年积累的石英坩埚生产经验及技术，引进技术团队，加大研发投入，改进生产工艺，持续提升半导体级石英坩埚生产线自动化水平，不断完善生产管理体系。通过这些措施，公司在资源分配上既重视光伏领域的稳定发展，也着力于半导体领域的技术进步和市场拓展，以实现公司业务多元化和风险分散。 6、请问贵公司未来发展方向在哪里？ 公司将始终紧跟单晶硅材料产业链的发展趋势，以技术创新及产品升级作为重要的发展引擎，在保证原有客户供应的前提下积极拓展新客户，建立稳固可靠的客户关系，不断进行技术创新、产品创新、制造方式创新，为客户提供更高品质、更具性价比的产品和服务。加快半导体石英坩埚的产品升级投入，逐步扩大公司在半导体产业的市场份额，分散行业风险。同时围绕光伏、半导体产业链积极布局新业务，
--	--

	通过技术创新和产业协同培育多元化利润增长点，持续优化公司产品结构和业务组合，全面提升企业核心竞争力和抗风险韧性。 7、目前公司资产负债情况如何？短期借款、长期借款的结构如何，是否存在短期偿债压力？ 截至 2025 年 6 月末，公司的流动比率和速动比率分别为 2.35 倍和 2.20 倍，具备较好的短期偿债能力。公司资产负债率为 52.62%，较上年末有所上升，但整体来看，公司的资产流动性和偿债能力较好，偿债风险较低。公司目前的资产负债结构合理，长短期借款结合，大额资本支出主要为半导体石英坩埚建设项目，与该项目募集资金相匹配。公司现金资产结余充裕，现金流情况良好，可满足正常生产经营需要。 8、公司目前现金流情况是怎样的，存货跌价准备计提金额较去年同期相比有何调整，计提政策是否因行业价格波动进行优化？ 截至 2025 年 6 月末，公司现金资产（包括银行存款、理财资金、大额存单等）结余充裕，可以满足正常生产经营需要。2025 年上半年，公司存货跌价准备计提金额为 2,705.60 万元，较去年同期大幅减少。公司存货跌价准备的计提，严格按照会计准则执行。公司对存货采用成本与可变现净值孰低进行减值测试，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 8 日